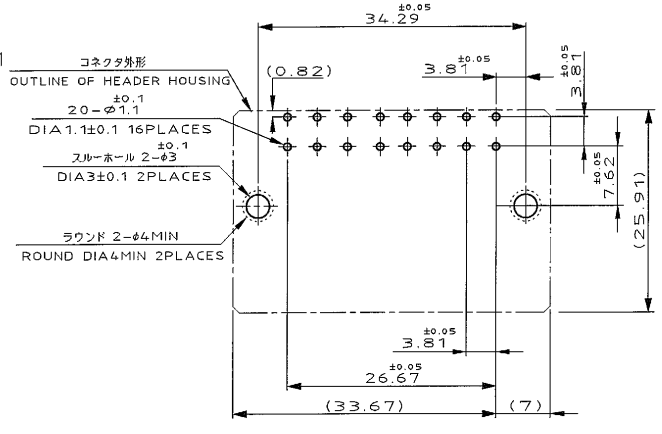
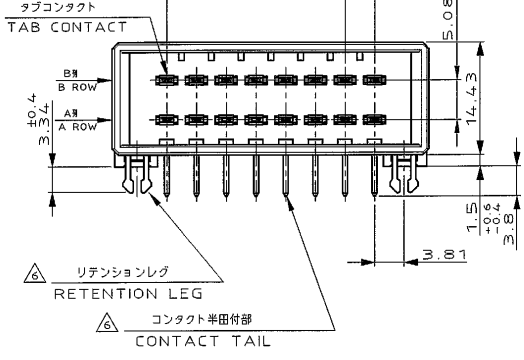
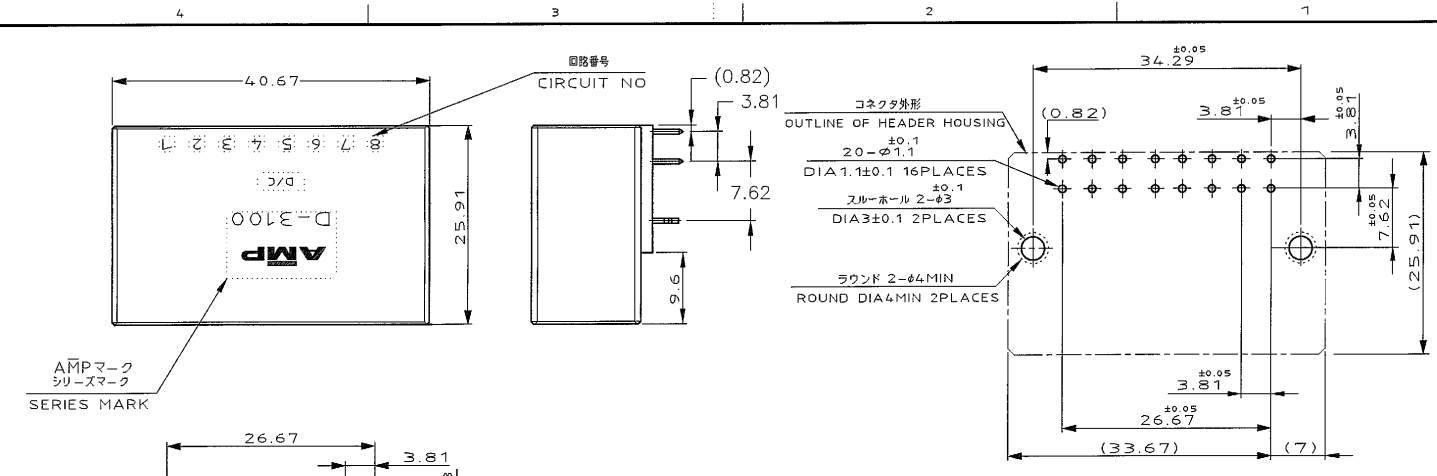


NUMBER 178307
3rd ANGLE PROJECTION
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST
AMP-J
REV.10/83



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38µm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76µm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - △ FINISH (CONTACT AREA): 2.0µm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - △ FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - △ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
厚膜部: 0.38µm MIN金めっき
 - △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
厚膜部: 0.76µm MIN金めっき
 - △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
厚膜部: 2.0µm MINスズめっき
 - △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
 - △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

| | | |
|----------|---|-----------------|
| △ | △ | 178307-5 |
| △ | △ | 178307-3 |
| △ | △ | 178307-2 |
| (FINISH) | | 製品番号 (PART NO.) |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | Copyright © 1993 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. | | tyco Electronics | | Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan | |
| WIRE RANGE | | INSULATION DIA | | NAME | | タイフニック D3100 水平タイプ 16 極 ヘッダーアセンブリー | | | |
| MATERIAL | | FINISH | | 16 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASSY FOR DYNAMIC 3100 | | | | | |
| SEE NOTE | | SEE NOTE | | GENERAL TOLERANCE | | SIZE LOC NUMBER | | C=178307 | |
| DR: 16/MAR/95 K.IKEDA | | DE: 16/MAR/95 K.IKEDA | | 100% 20.3 | | A3 J | | SCALE | |
| CHK: S.MANTBE | | APP: S.MANTBE | | 30% 20.45 | | 2-1 | | REV. C | |
| LTR | | REVISION RECORD | | DR | | CHK | | DATE | |
| | | | | | | | | | |

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面